

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Oktober 2002 (24.10.2002)

PCT

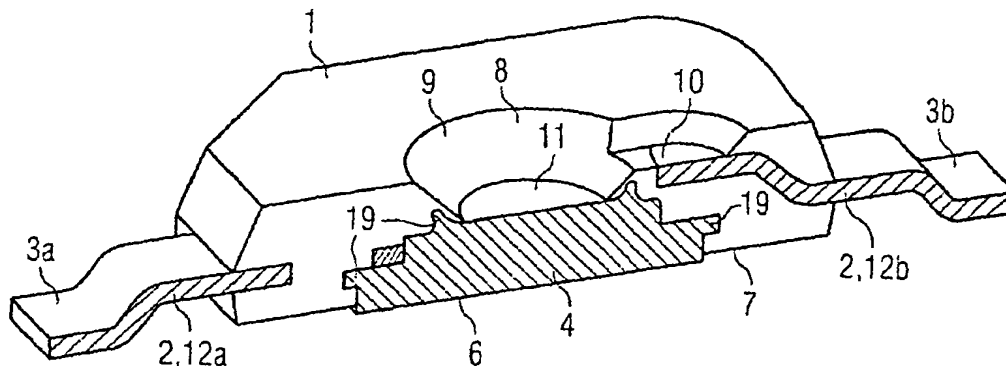
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/084749 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01L 33/00** (72) **Erfinder; und**
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/01306 (75) **Erfinder/Anmelder (nur für US): BOGNER, Georg**
(22) Internationales Anmeldedatum: 9. April 2002 (09.04.2002) [DE/DE]; Am Sandbühl 12, 93138 Lappersdorf (DE).
(25) Einreichungssprache: Deutsch **BRUNNER, Herbert** [DE/DE]; Winklergasse 16, 93047 Regensburg (DE). **HIEGLER, Michael** [DE/DE]; Killemannstr. 45, 93049 Regensburg (DE). **WAITL, Günter** [DE/DE]; Prachweg 3, 93049 Regensburg (DE).
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (74) **Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER**; Ridlerstrasse 55, 80339 München (DE).
(30) Angaben zur Priorität: 101 17 889.1 10. April 2001 (10.04.2001) DE (81) **Bestimmungsstaaten (national):** CN, JP, US.
(71) **Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH & CO. OHG** [DE/DE]; Wernerwerkstr. 2, 93049 Regensburg (DE). (84) **Bestimmungsstaaten (regional):** europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) **Title:** CONDUCTOR FRAME AND HOUSING FOR A RADIATION-EMITTING COMPONENT, RADIATION EMITTING COMPONENT AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) **Bezeichnung:** LEITERRAHMEN UND GEHÄUSE FÜR EIN STRAHLUNGSEMITTIERENDES BAUELEMENT, STRAHLUNGSEMITTIERENDES BAUELEMENT SOWIE VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG



(57) **Abstract:** The invention relates to a conductor frame (2) and a housing, in addition to a radiation-emitting component formed therewith and a method for the production thereof. The conductor frame has a support part with at least one binding wire connecting area (10) and at least one electric soldered connecting strip (3a,b), in which a separately built thermal connecting part (4) having a chip assembly area (11) is attached. In order to form the housing, the conductor frame (2) is enveloped with a molded material, wherein the thermal connecting part is embedded in such a way that it can be thermally connected from the outside.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung beschreibt einen Leiterraahmen (2) und ein Gehäuse sowie ein damit gebildetes strahlungsemitierendes Bauelement und ein Verfahren zu dessen Herstellung. Der Leiterraahmen weist dabei ein Trägerteil mit mindestens einem Bonddrahtanschlußbereich (10) und mindestens einem elektrischen Lötanschlußstreifen (3a,b) auf, in das ein separat gefertigtes thermisches Anschlussteil (4) eingeknüpft ist, das einen Chipmontagebereich (11) aufweist. Zur Bildung eines Gehäuses ist der Leiterraahmen (2) vorzugsweise mit einer Formmasse umhüllt, wobei das thermische Anschlussteil so eingebettet wird, dass es von außen thermisch anschliessbar ist.

WO 02/084749 A2



Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Docket # P2001,0258

Applic. # _____

Applicant Georg Bogner et al.

Lerner and Greenberg, P.A.

Post Office Box 2480

Hollywood, FL 33022-2480

Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101